

2025年3月期 第3四半期 決算説明資料



日本高純度化学株式会社

証券コード：4973

2025年1月28日





決算の概況





(注) 当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合によって大きく変動します。
- 貴金属は価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。

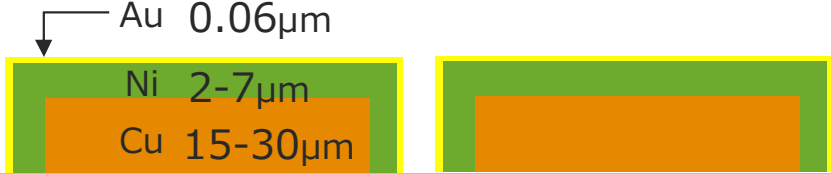
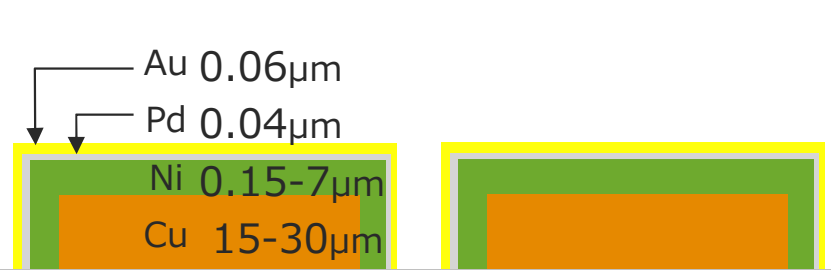


めっき方式の説明

用語	最終用途	説明
電解めっき	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	PC・スマホ等のプリント基板（CPU・GPU等）	高純度な純金めっき
硬質金めっき	スマートフォン・車載・産業機械等のコネクタ	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウムめっき	PC・車載・産業機械等のリードフレーム	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換金めっき	DRAM・NAND等の半導体メモリ サーバー・PC・スマートフォン等の半導体搭載基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元金めっき	半導体搭載基板 サーバー・PC等のCPU・GPU等	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法
還元パラジウムめっき	サーバー・PC等の半導体搭載基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法（金めっきの下地として使用される）

製品ラインアップ

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	テンペレジストシリーズ
	硬質金		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元パラジウム		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属（銅、スズ、ニッケル）、合金めっき、後処理剤など	

めっきプロセスの説明

用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Ni-Au Electroless Nickel Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06μm Ni 2-7μm Cu 15-30μm</p>
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法 薄ニッケル化の動きが進んでいる。 層構成はCu-Ni-Pd-Au Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06μm Pd 0.04μm Ni 0.15-7μm Cu 15-30μm</p>
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。 層構成はCu-Au Direct Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06μm Cu 15-30μm</p>
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Pd-Au Electroless Palladium Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06μm Pd 0.04μm Cu 15-30μm</p>

2025年3月期 第3四半期決算概況

電子部品業界の状況

- 生成AI向けの旺盛な需要に牽引され、AIサーバやデータセンター向けが堅調に推移したが、スマートフォンやパソコンなどで需要が伸び悩み、産業機器向けは在庫調整の長期化により需要回復に遅れ
- 車載用電子部品については、運転支援システムなどの電装化による継続的な需要増はあったものの、世界的な自動車販売減速やEV市場の成長鈍化による在庫調整から停滞

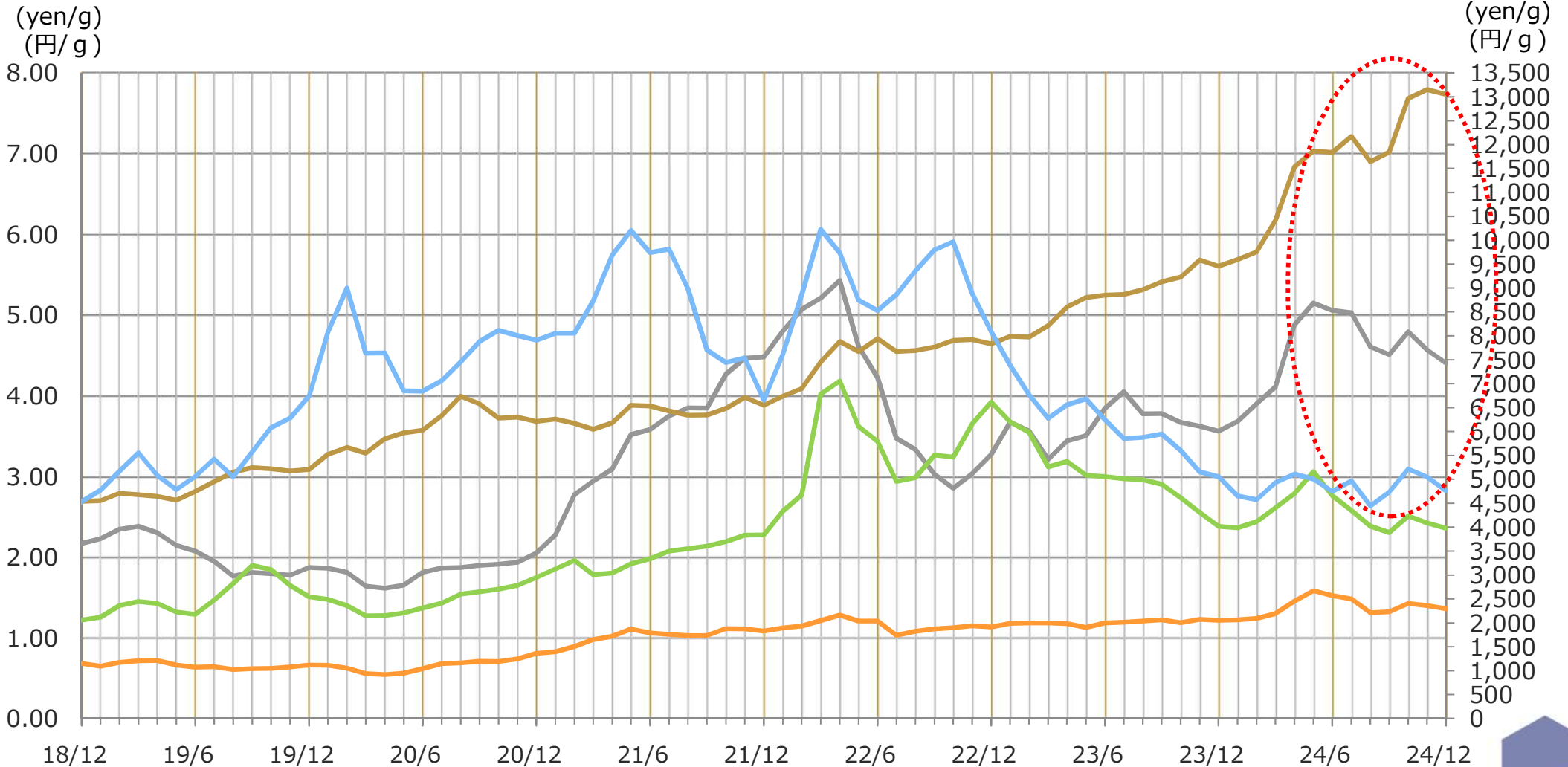
当社の概況

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品
生成AI関連の半導体パッケージやモジュール向けが堅調に推移し、スマートフォンやPC等の民生向けの販売は緩やかに回復
- コネクタ用めっき薬品
車載向けは、在庫調整の影響を受けて減速し、産業機器向けで低迷したが、スマートフォン向けは当社製品の優位性（省金効果）から底堅く推移
- リードフレーム用めっき薬品
当社製品の品質安定性が評価され、スマートフォンやPC向けで増収

メタル相場推移

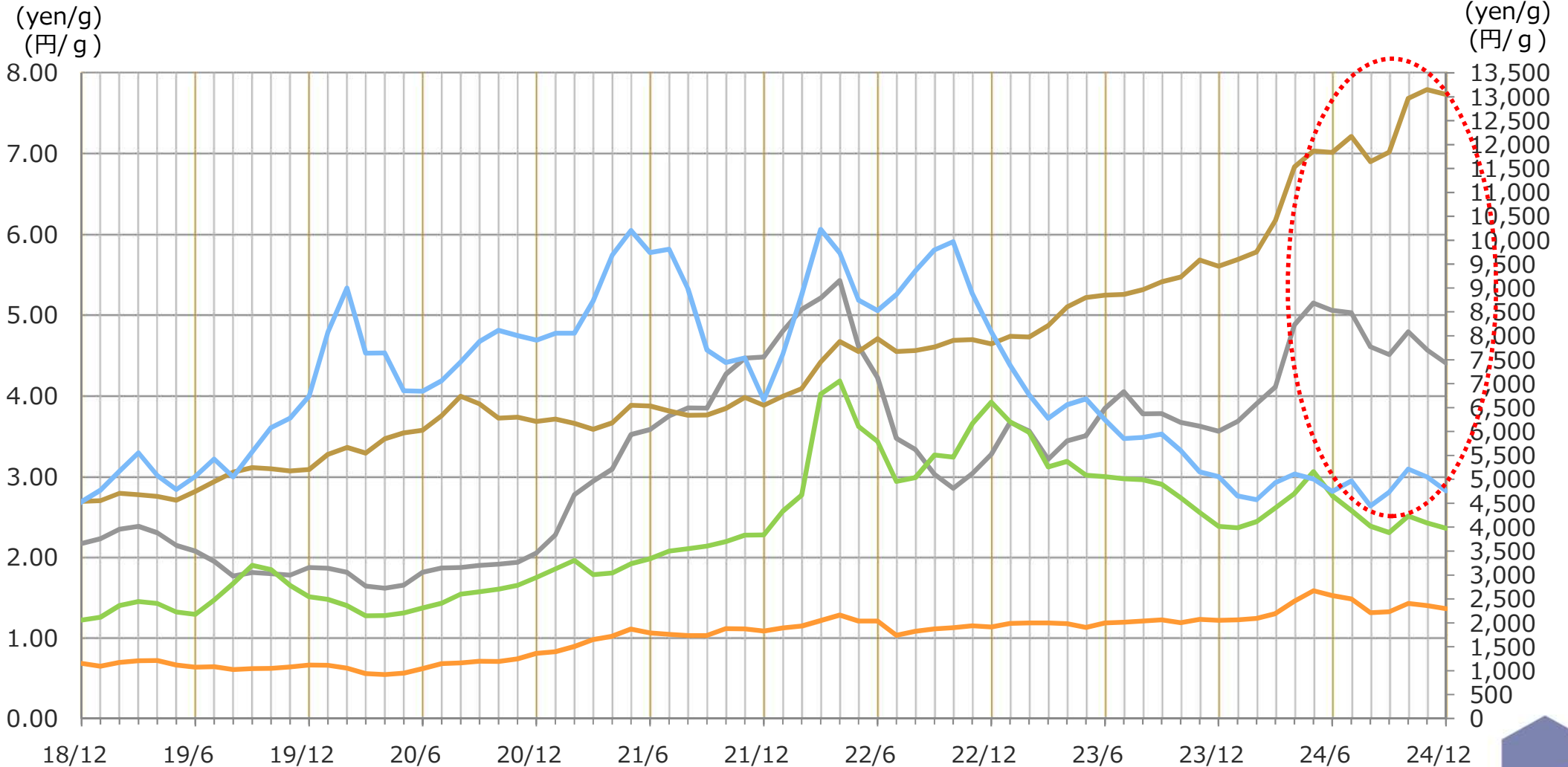
Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

Copper 銅
Tin スズ
Nickel ニッケル



Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格

Gold 金
Palladium パラジウム



2025年3月期 第3四半期決算概況

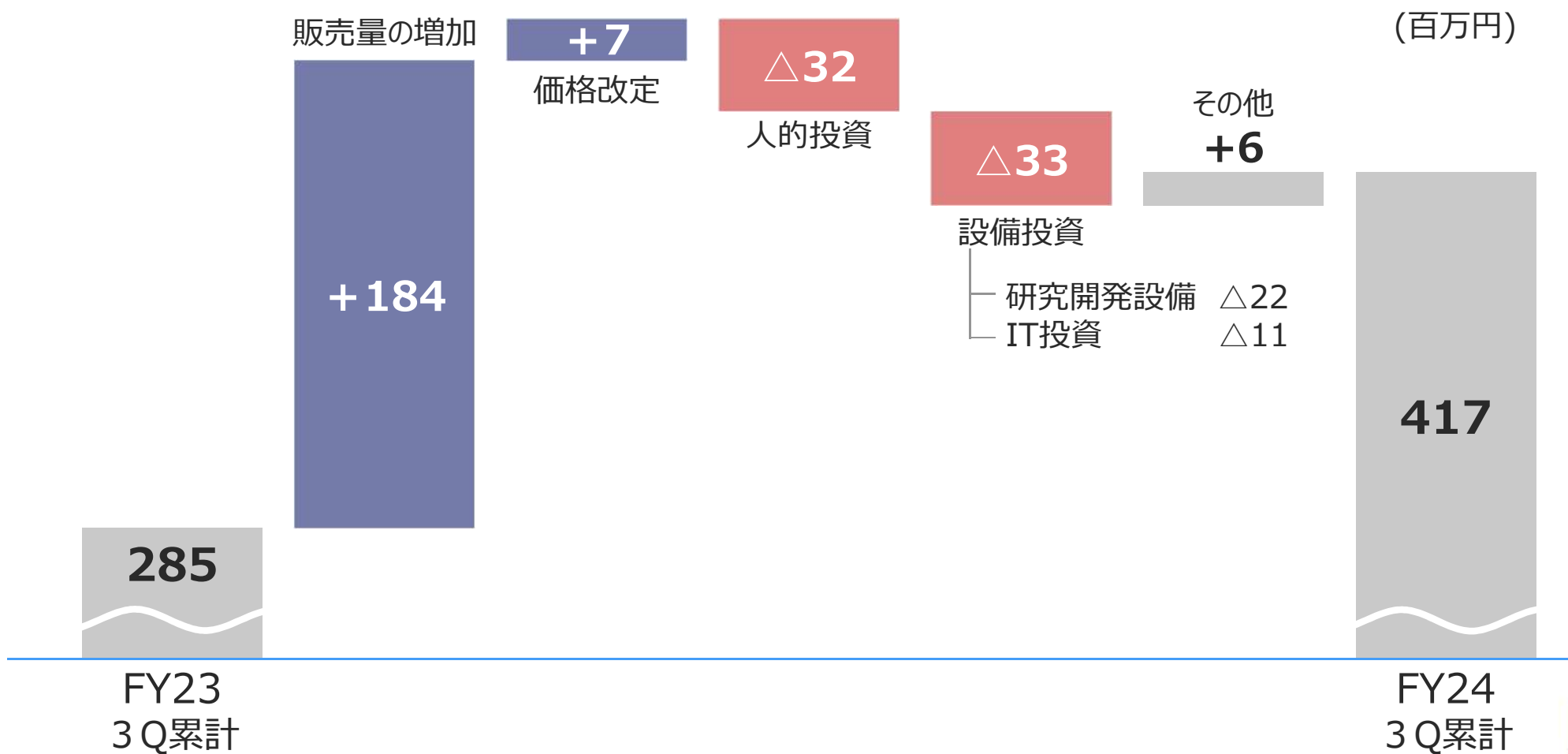
- 産業機器向けは低迷したものの、スマートフォンやPC等民生向けの販売に一定の回復が見られ、AIサーバ/データセンター向けの需要が堅調に推移した結果、前年同期比で増収増益
- 純利益は、保有株式の売却益を計上したことにより、前年同期比大幅増

(単位：百万円)

	2024/3期 3Q累計	2025/3期				増減率
		1Q	2Q	3Q	3Q累計	
売上高	8,721	3,079	3,251	3,731	10,061	+15.4%
営業利益	285	149	117	150	417	+46.4%
経常利益	479	241	118	203	563	+17.6%
四半期純利益	370	271	550	509	1,331	+259.1%
1株当たり 四半期純利益	64.45円	47.09円	95.42円	88.25円	230.83円	—

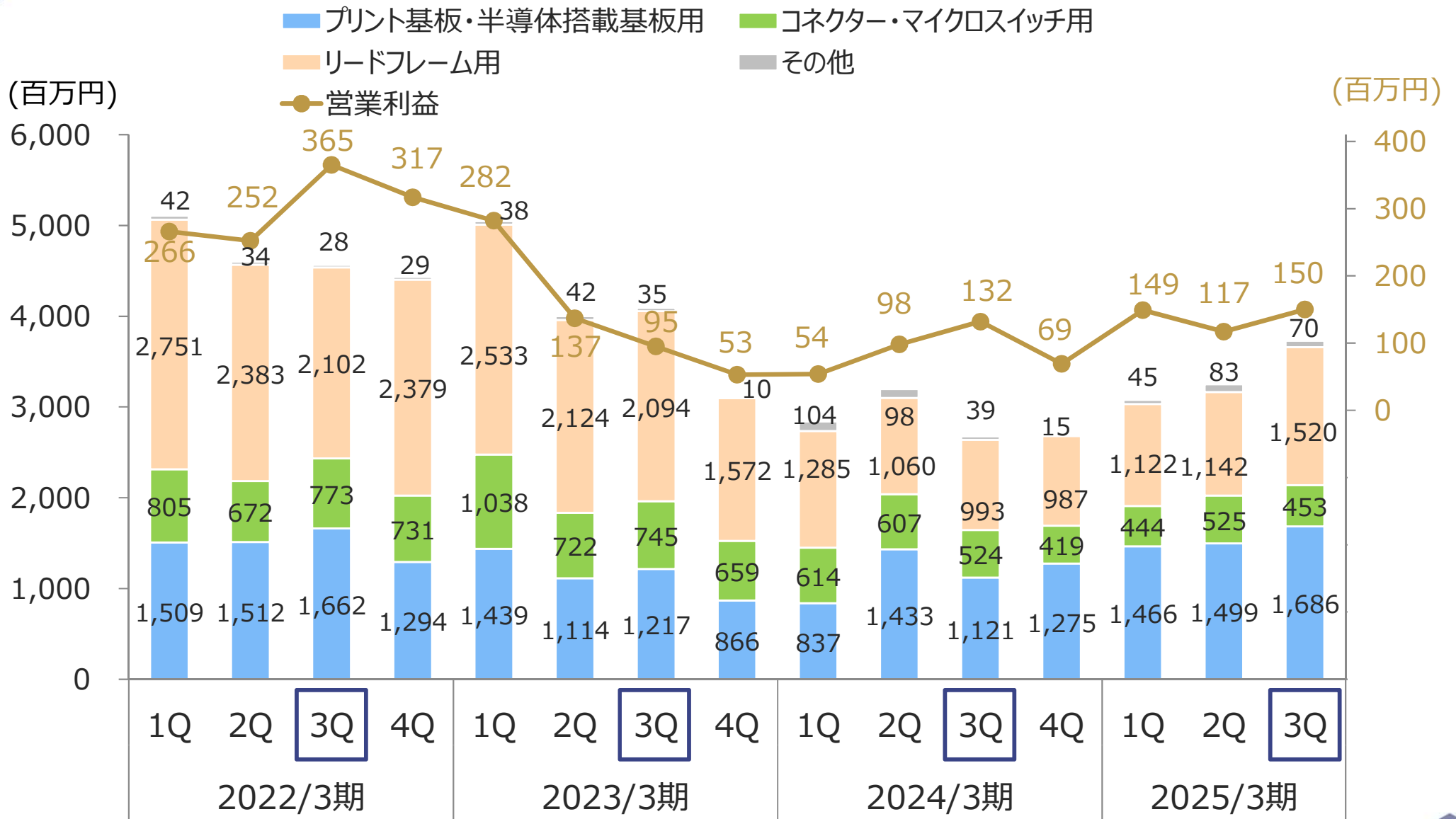
営業損益増減要因（前年同期比：3Q累計）

- 産業機器及び車載向けに本格的な需要回復は見られなかったものの、スマホ・PCなど民生品の需要は回復傾向
- 積極的な成長投資（人的投資、研究開発設備投資等）を実施

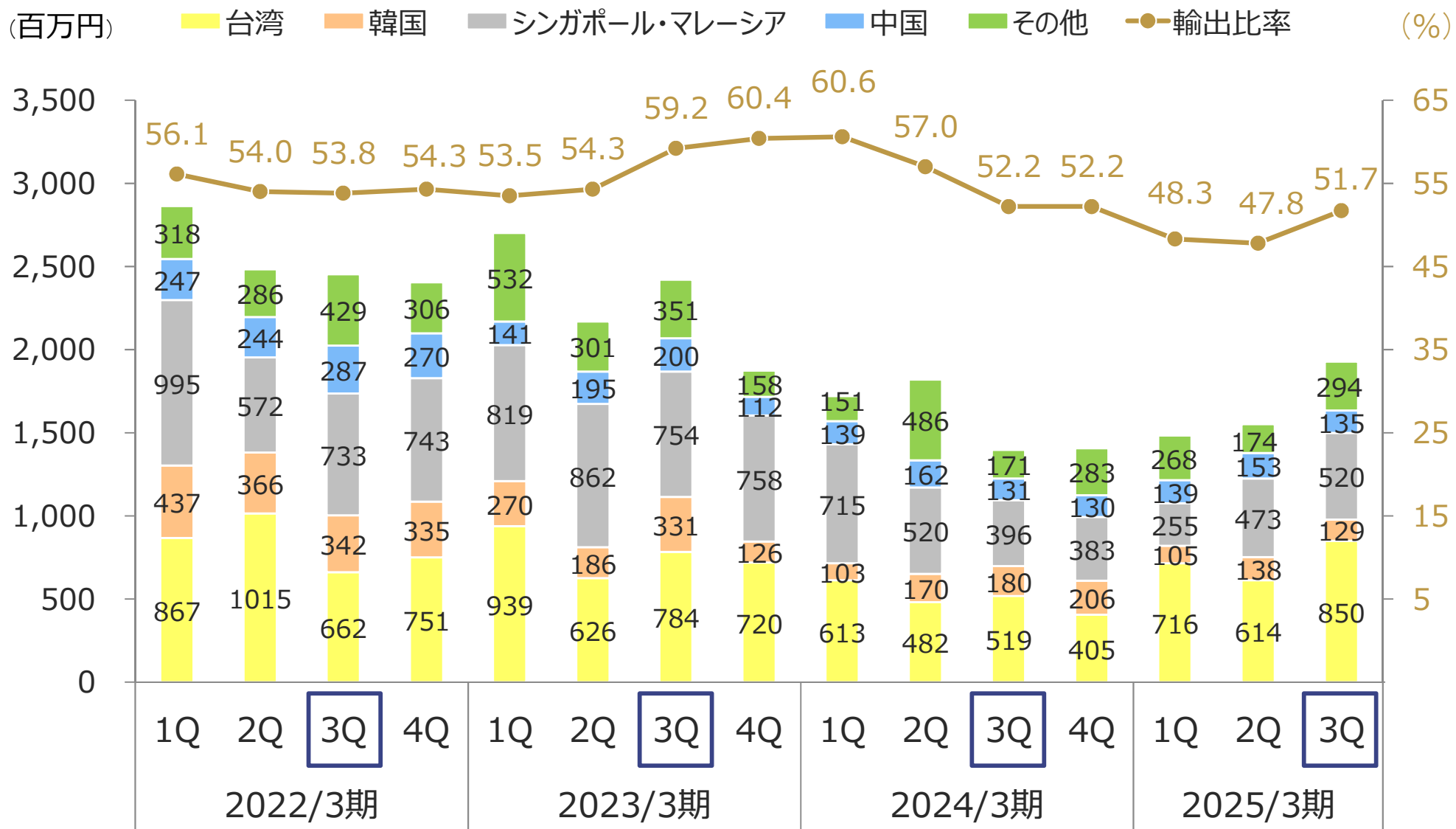


注) 当社は為替予約により為替変動の影響を最小限に留めています。

売上高・営業利益の推移（四半期ベース）



輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



2025年3月期 通期見通し

- サーバ/データセンター向けは生成AI向けの旺盛な需要増に牽引され堅調な推移を予想
- スマートフォンやPC等の民生品向けは目先の需要回復に減速のリスクあり
- 車載向けは電気自動車の需要鈍化による在庫調整局面にあり、産業機器向けは本格的な回復時期が依然として見通せない状況が継続
- 上記を踏まえ、通期見通しは据え置く

(単位：百万円)

	2024/3期	2025/3期			
		期初公表値 (2024年4月)	最新公表値 (2024年10月)	増減率	
				前期比	期初公表比
売上高	11,419	13,000	13,000	+13.8%	—
営業利益	354	500	500	+41.1%	—
経常利益	553	680	680	+22.9%	—
当期純利益	548	580	1,580	+188.2%	+172.4%
配当	101円	126円	126円	+25円	—
ROE	3.9%	4.0%	11.3%	—	—

政策保有株式売却の進捗

- 当社は政策保有株式について、「事業戦略及び取引先との事業場の関係協力、フィードバックが期待できる企業の株式のみを保有し、今後1～2年以内に純資産割合の20%未済までの縮減を図る」との方針を掲げています。 ※1
- 上記方針に沿って過去1年間で1,755百万円の売却を実施しており、引き続き売却を進めています。

※1 2024年3月22日開示の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」参照

	2023年12月末	2024年3月末	2024年6月末	2024年9月末	2024年12月末
売却額 ※2 (百万円)	0	307	142	752	553
保有株式時価 (百万円)	8,748	8,796	9,069	7,236	7,108
純資産額 (百万円)	14,229	14,537	14,683	14,052	14,149
純資産に対する割合 (%)	61.5	60.5	61.8	51.5	50.2

※2 該当四半期中での売却額

補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2024年12月末時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>